



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201621899 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 03

(21) 申请号 201020149876. X

(22) 申请日 2010. 04. 06

(73) 专利权人 河南鸿昌电子有限公司

地址 461500 河南省长葛市钟繇大道中段河南
鸿昌电子有限公司

(72) 发明人 陈建卫 钱俊有 张文涛 陈磊
赵丽萍 张甜

(51) Int. Cl.

F25B 21/04 (2006. 01)

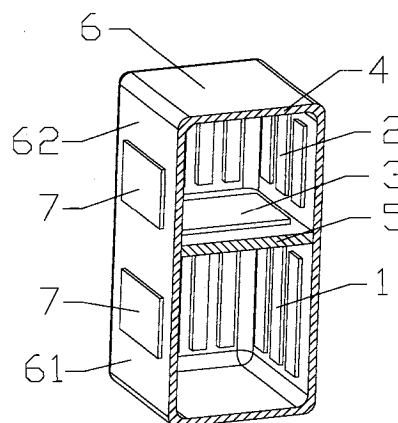
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种半导体多温箱

(57) 摘要

本实用新型涉及多温箱, 尤其涉及一种半导体多温箱, 其包括冷却室、加热室和半导体器件, 冷却室和加热室由室壁构成, 冷却室和加热室中间的是共同室壁, 其余的是外围室壁, 即冷却室外围的是冷却室外围室壁, 加热室外围的是加热室外围室壁, 共同室壁中间具有连接直流电源的半导体器件, 其特征是: 所述的外围室壁内还具有连接直流电源的另外半导体器件。或所述的另外半导体器件位于冷却室外围室壁。或所述的另外半导体器件位于加热室外围室壁。这样的半导体多温箱具有既可以使冷却室降温 and 加热室升温同时进行, 又可以使两室单独改变温度的优点。



1. 一种半导体多温箱,包括冷却室、加热室和半导体器件,冷却室和加热室由室壁构成,冷却室和加热室中间的是共同室壁,其余的是外围室壁,即冷却室外围的是冷却室外围室壁,加热室外围的是加热室外围室壁,共同室壁中间具有连接直流电源的半导体器件,其特征是:所述的外围室壁内还具有连接直流电源的另外半导体器件。

2. 根据权利要求1所述的半导体多温箱,其特征是:所述的另外半导体器件位于冷却室外围室壁。

3. 根据权利要求1所述的半导体多温箱,其特征是:所述的另外半导体器件位于加热室外围室壁。

一种半导体多温箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及多温箱,是涉及一种可以同时具有冷藏箱和保温箱的箱体,是涉及一种半导体多温箱。

背景技术

[0002] 目前所涉及到的半导体多温箱具有冷却室和加热室,在冷却室和加热室的夹壁具有半导体器件,半导体通过直流电流将会使其一侧温度升高,即致使加热室升温,一侧温度降低,即致使冷却室降温,这样的多温箱只具有一组半导体器件,这就具有冷却室降温 and 加热室升温同时进行的缺点,不能解决现实生活中,一个温度达到后,另一个不需要变化的矛盾。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种既可以使冷却室降温 and 加热室升温同时进行,又可以使两室单独改变温度的半导体多温箱。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:半导体多温箱,包括冷却室、加热室和半导体器件,冷却室和加热室由室壁构成,冷却室和加热室中间的是共同室壁,其余的是外围室壁,即冷却室外围的是冷却室外围室壁,加热室外围的是加热室外围室壁,共同室壁中间具有连接直流电源的半导体器件,其特征是:所述的外围室壁内还具有连接直流电源的另外半导体器件。

[0005] 进一步的讲,所述的另外半导体器件位于冷却室外围室壁。

[0006] 进一步的讲,所述的另外半导体器件位于加热室外围室壁。

[0007] 本实用新型的有益效果是:这样的半导体多温箱具有既可以使冷却室降温 and 加热室升温同时进行,又可以使两室单独改变温度的优点。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型半导体多温箱的结构示意图

[0009] 其中:1、冷却室 2、加热室 3、半导体器件 4、室壁 5、共同室壁 6、外围室壁 61、冷却室外围室壁 62、加热室外围室壁 7、另外半导体器件

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0011] 如图 1 所示半导体多温箱,包括冷却室 1、加热室 2 和半导体器件 3,冷却室 1 和加热室 2 由室壁 4 构成,冷却室 1 和加热室 2 中间的是共同室壁 5,其余的是外围室壁 6,即冷却室 1 外围的是冷却室外围室壁 61,加热室 2 外围的是加热室外围室壁 62,共同室壁 4 中间具有连接直流电源的半导体器件 3,其特征是:所述的外围室壁 6 内还具有连接直流电源的另外半导体器件 7。

[0012] 进一步的讲,所述的另外半导体器件 7 位于冷却室外围室壁 61。

[0013] 进一步的讲,所述的另外半导体器件 7 位于加热室外围室壁 62。

[0014] 在一个室达到温度后可以使用外围室壁里的另外半导体器件对冷却室或加热室进行改变温度,而另一个温度不变,使用方便。

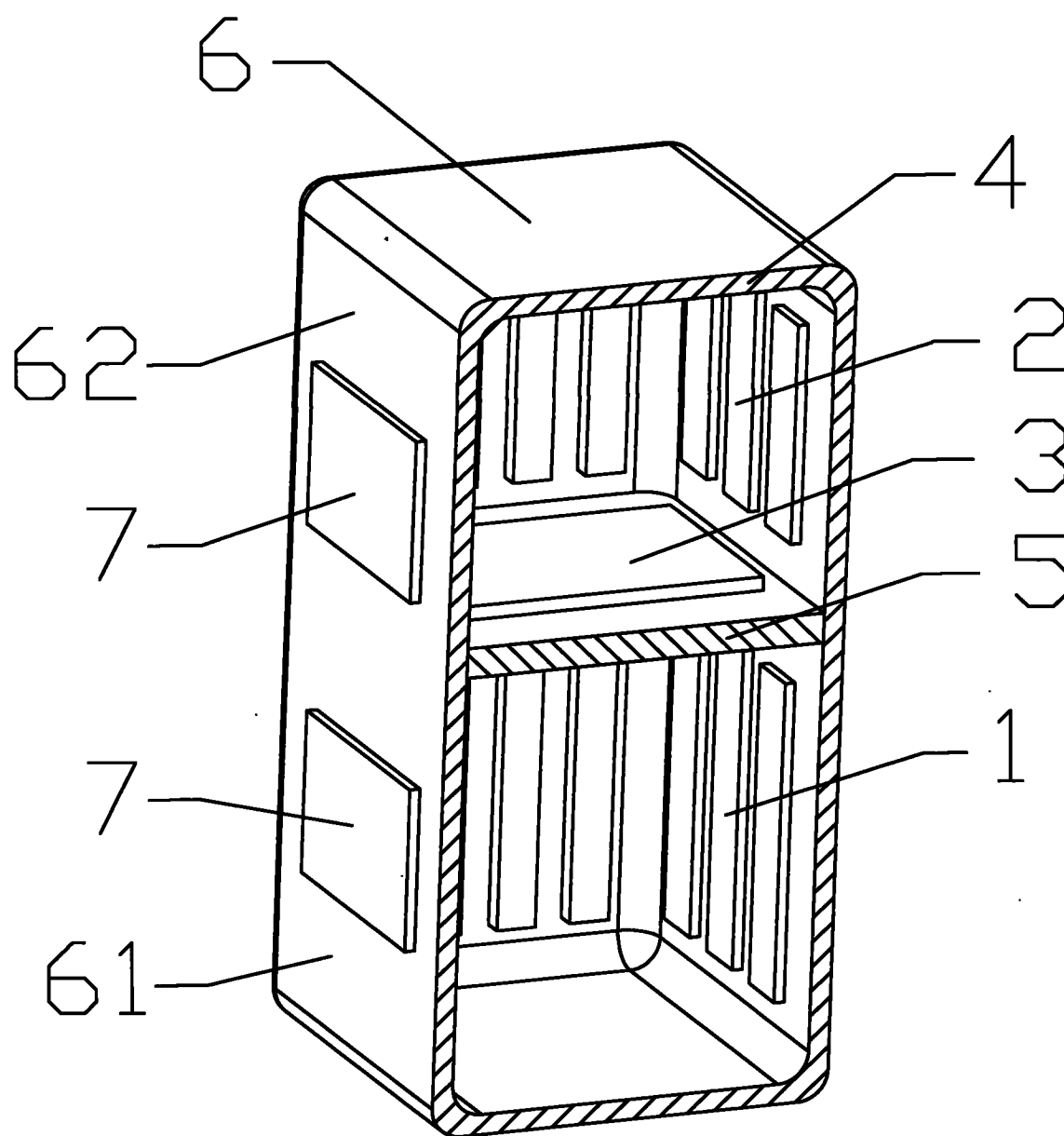


图 1